

Infineon Technologies und Mitsubishi Electric vereinbaren globale Zusammenarbeit im Bereich Leistungselektronik

Zwei weltweite Marktführer bündeln ihre Stärken und bieten modernste Leistungs-Module für industrielle Antriebslösungen an

Neubiberg / Ratingen – 3. Mai 2010, Infineon Technologies AG und Mitsubishi Electric Corporation haben sich darauf verständigt, eine Service-Vereinbarung abzuschließen, um den Markt für industrielle Steuerungen und Antriebe mit den fortschrittlichen IGBT-Modulen SmartPACK und SmartPIM weltweit zu beliefern. Dieses revolutionäre Gehäuse-Konzept wurde von Infineon Technologies entwickelt und wird bestückt mit der neuesten Generation von Leistungshalbleiter-Produkten beider Unternehmen zum Einsatz kommen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Mitsubishi Electric seine neueste Generation von Leistungshalbleitern unterschiedlicher Leistungsbereiche (derzeitige Stromklassen von 15 A bis 150 A mit Spannungen von 600 V und 1200 V) in den Smart-1/-2/-3-Gehäusen von Infineon anbieten. Infineon hat das neue SmartPACK/SmartPIM Modul-Konzept entwickelt und wird das gleiche Portfolio vollständig kompatibler Produkte weiterhin auf Basis seiner eigenen Chip-Technologien und Modul-Fertigung anbieten. Anwender der SmartPACK/SmartPIM-Produkte können zukünftig von der Kooperation der zwei weltweit führenden IGBT-Modul-Hersteller profitieren.

Über Mitsubishi Electric

Seit über 85 Jahren versorgt Mitsubishi Electric sowohl Unternehmenskunde als auch Endverbraucher auf der ganzen Welt mit seinen bewährten, qualitativ hochwertigen Produkten. Mitsubishi Electric Corporation ist damit ein anerkannter Weltmarktführer in Herstellung, Marketing und Verkauf elektrischer sowie elektronischer Ausstattungen für die Bereiche Informationsverarbeitung und Kommunikation, Weltraumentwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnologie, Energie, Transport- und Bauwesen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des japanischen Konzerns. Das Unternehmen unterstützt europäische Kunden mit innovativen Technologien und Produkten höchster Qualität ihre Herausforderungen im Geschäftsalltag zu meistern.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 25.650 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2009 (Ende September) einen Umsatz von 3,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.



SmartPACK/-PIM product series outline:

Housing concept: Smart-1, Smart-2, Smart-3

Current range: 15 to 200A

Voltage class: 600V, 1200V

Functionalities & Features:

- Latest IGBT/FWD power-pack in 3-phase 3-phase output configuration with internal temp monitoring device (For SmartPACK types)
- Latest IGBT/FWD inverter and Diode converter power-pack in 3-phase output and 3-phase input configuration with brake function and internal temp monitoring device (For SmartPIM types)
- Solder-less and single-bolt module mounting using press-fit terminal arrangement

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Semiconductor European Business Group
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen

Tel. +49 (21 02) 486-5270

semis.info@meg.mee.com
www.mitsubishichips.com